

证券代码: 300656

证券简称: 民德电子

公告编号: 2026-047

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于为控股子公司提供项目贷款授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次为控股子公司浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）新增提供15,000万元担保额度，本次公告涉及对资产负债率超过70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产50%，未对合并报表外单位提供担保，尚需提交公司股东会审议，敬请投资者关注相关风险。

公司于2026年8月4日在公司会议室召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供项目贷款授信担保的议案》，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会进行审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司广芯微电子因晶圆厂产能提升等业务需求，拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）申请固定资产暨项目融资借款人民币15,000万元（大写：壹亿伍仟万元整），贷款期限10年。公司和广芯微电子股东、总经理谢刚先生及其配偶为该笔贷款提供连带责任保证担保，广芯微电子为该笔项目贷款提供机器设备抵押担保。

根据中国证监会和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
民德电子	广芯微电子	50.1%	101.64%	12,050	15,000	30.84%	否

注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2025 年经审计财务报表或 2026 年 3 月 31 日未经审计的数据，以数据孰高为准；

（2）文中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司 2025 年 12 月 31 日经审计归属于母公司股东净资产的比例。

（3）公司分别于 2026 年 5 月 9 日、2026 年 6 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》，同意广芯微电子以增资扩股的方式引入投资者，公司放弃广芯微电子的优先认购权，增资完成后，公司持有广芯微电子的股权比例下降至 42.3380%，公司仍为广芯微电子控股股东，广芯微电子董事会 7 名董事中有 4 名董事由公司委派，公司仍对广芯微电子实施控制。具体详见公司于 2026 年 5 月 9 日、2026 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-030），《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-042）。目前，相关增资的具体程序尚在办理当中。

三、被担保人基本情况

- 1.公司名称：浙江广芯微电子有限公司
- 2.成立日期：2021 年 10 月 9 日
- 3.注册资本：5,545.4545 万人民币
- 4.注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122 号
- 5.法定代表人：谢刚
- 6.公司类型：其他有限责任公司
- 7.经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 8.最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	879,439,698.61	895,941,950.62
负债总额	853,670,474.20	910,596,273.94

其中：银行贷款总额	361,208,299.59	347,194,778.75
流动负债总额	552,437,925.56	617,792,777.90
净资产	25,769,224.41	-14,654,323.32
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	62,424,936.16	27,445,098.70
利润总额	-211,765,143.88	-40,423,547.73
净利润	-211,718,634.83	-40,423,547.73

9.股权结构：公司持有 50.1%股权，谢刚持有 35.0656%股权，丽水市高质量发展绿色发展产业基金有限公司持有 13.8344%股权，周存旭持有 1%股权。

10.与公司的关系：系公司合并报表范围内的控股子公司。

11.被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次贷款担保事项尚未签署合同，公司将在担保事项经股东会审议批准后，在以下担保方案框架内签署最终的担保协议：

1.债权人：中国光大银行股份有限公司上海分行

2.保证人：民德电子、谢刚及配偶

3.担保金额：15,000 万元

4.借款期限：10 年

5.保证方式：连带责任保证

6.保证范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费、鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用

7.保证担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同项下债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年

8.涉及的其它担保：机器设备抵押，因目前广芯微电子新增部分设备正在采购过程中，后续根据设备到位时间另行与债权人办理机器设备抵押手续

五、董事会意见

晶圆代工厂广芯微电子作为公司未来核心发展业务，目前经营情况良好，本

次向银行申请中长期的固定资产项目贷款，是综合考虑了项目进展以及资金需求情况，有利于促进公司及子公司业务发展和业务规模的扩大，加快广芯微电子产能提升进度，符合公司长远整体利益。

公司为广芯微电子提供全额担保，同时广芯微电子股东、总经理谢刚先生及其配偶也为广芯微电子提供全额担保；本次被担保对象为公司控股子公司广芯微电子，公司能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，担保风险可控，不会损害公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东会审议；同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层审核签署前述担保额度范围内有关的合同、协议等各项法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额为 35,630 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.62%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2. 《固定资产暨项目融资借款合同》及《保证合同》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2026年8月4日